



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 211875486 U

(45) 授权公告日 2020.11.06

(21) 申请号 201922471658.1

(22) 申请日 2019.12.31

(73) 专利权人 深圳市凯威达电子有限公司

地址 518000 广东省深圳市宝安区新安街
道留仙二路(隆昌路10号)丰业源工业
厂区B1、B2栋之B1栋205室

(72) 发明人 蒙文钱

(74) 专利代理机构 深圳市海盛达知识产权代理
事务所(普通合伙) 44540

代理人 赵雪佳

(51) Int.Cl.

F16M 11/04 (2006.01)

H04B 1/40 (2015.01)

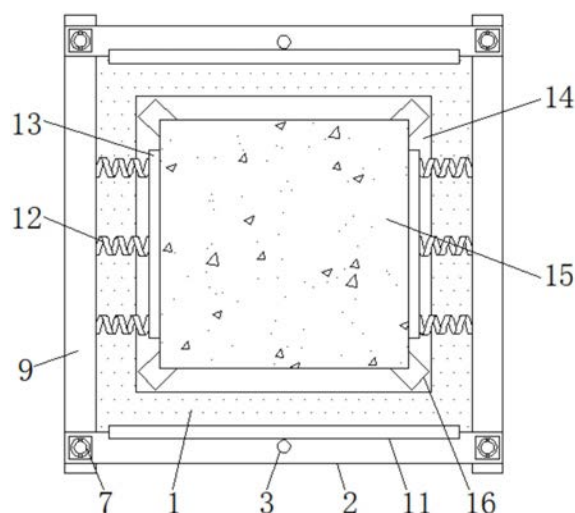
权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54) 实用新型名称

一种具有防磨损结构的载波芯片

(57) 摘要

本实用新型属于载波芯片技术领域,尤其为一种具有防磨损结构的载波芯片,包括安装板、竖板和连接板,所述安装板的外侧安装有横板,且横板的中间位置设置有连接轴,并且连接轴的中间位置固定有齿轮,所述齿轮的外侧连接有齿板,且齿板与齿轮之间为活动连接,并且齿板的端头处固定有压块,所述压块的外侧设置有活动块,且活动块的内部设置有第一弹簧,所述竖板安装于横板的端头处,且竖板的上表面开设有限位槽,并且横板的边侧固定有防护垫,所述竖板的表面连接有第二弹簧的一端,且第二弹簧的另一端设置有夹板。该具有防磨损结构的载波芯片,载波芯片在使用时安装较为稳定,并且不易出现磨损损坏的情况,提高了整体的实用性。



1. 一种具有防磨损结构的载波芯片,包括安装板(1)、竖板(9)和连接板(14),其特征在于:所述安装板(1)的外侧安装有横板(2),且横板(2)的中间位置设置有连接轴(3),并且连接轴(3)的中间位置固定有齿轮(4),所述齿轮(4)的外侧连接有齿板(5),且齿板(5)与齿轮(4)之间为活动连接,并且齿板(5)的端头处固定有压块(6),所述压块(6)的外侧设置有活动块(7),且活动块(7)的内部设置有第一弹簧(8),所述竖板(9)安装于横板(2)的端头处,且竖板(9)的上表面开设有限位槽(10),并且横板(2)的边侧固定有防护垫(11),所述竖板(9)的表面连接有第二弹簧(12)的一端,且第二弹簧(12)的另一端设置有夹板(13),所述连接板(14)固定于安装板(1)的中间位置,且连接板(14)的外侧设置有芯片本体(15),并且芯片本体(15)的端头处固定有固定块(16)。

2. 根据权利要求1所述的一种具有防磨损结构的载波芯片,其特征在于:所述齿板(5)关于齿轮(4)的轴线对称设置有2个,且齿板(5)与齿轮(4)之间为啮合连接。

3. 根据权利要求1所述的一种具有防磨损结构的载波芯片,其特征在于:所述压块(6)与齿板(5)之间为一体化设置,且压块(6)和横板(2)之间构成滑动安装结构。

4. 根据权利要求1所述的一种具有防磨损结构的载波芯片,其特征在于:所述活动块(7)的底部采用倾斜状设置,且活动块(7)和横板(2)之间构成升降安装结构。

5. 根据权利要求1所述的一种具有防磨损结构的载波芯片,其特征在于:所述第二弹簧(12)等间距分布在夹板(13)的边侧,且夹板(13)的边侧与芯片本体(15)的外壁之间为紧密贴合。

6. 根据权利要求1所述的一种具有防磨损结构的载波芯片,其特征在于:所述芯片本体(15)关于安装板(1)的轴线对称设置,且芯片本体(15)的外侧对称设置有夹板(13)。

一种具有防磨损结构的载波芯片

技术领域

[0001] 本实用新型涉及载波芯片技术领域,具体为一种具有防磨损结构的载波芯片。

背景技术

[0002] 芯片是一种电路连接装置,芯片的体积较小,常常是计算机或其他电子设备的一部分,通过芯片进行连接,可靠性较高,随着科技的不断发展,芯片的功能越来越全面,然而现有的载波芯片存在以下问题:

[0003] 1、载波芯片在使用的过程中,耐磨性能较差,长时间使用后容易出现损毁的情况;

[0004] 2、载波芯片容易出现安装不稳的情况,在使用时受外力影响容易出现脱落的情况。

[0005] 针对上述问题,急需在原有具有防磨损结构的载波芯片的基础上进行创新设计。

实用新型内容

[0006] 本实用新型的目的在于提供一种具有防磨损结构的载波芯片,以解决上述背景技术中提出现有的具有防磨损结构的载波芯片,载波芯片在使用的过程中容易出现安装不稳的情况,并且容易磨损损坏,整体实用性较差的问题。

[0007] 为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:一种具有防磨损结构的载波芯片,包括安装板、竖板和连接板,所述安装板的外侧安装有横板,且横板的中间位置设置有连接轴,并且连接轴的中间位置固定有齿轮,所述齿轮的外侧连接有齿板,且齿板与齿轮之间为活动连接,并且齿板的端头处固定有压块,所述压块的外侧设置有活动块,且活动块的内部设置有第一弹簧,所述竖板安装于横板的端头处,且竖板的上表面开设有限位槽,并且横板的边侧固定有防护垫,所述竖板的表面连接有第二弹簧的一端,且第二弹簧的另一端设置有夹板,所述连接板固定于安装板的中间位置,且连接板的外侧设置有芯片本体,并且芯片本体的端头处固定有固定块。

[0008] 优选的,所述齿板关于齿轮的轴线对称设置有2个,且齿板与齿轮之间为啮合连接。

[0009] 优选的,所述压块与齿板之间为一体化设置,且压块和横板之间构成滑动安装结构。

[0010] 优选的,所述活动块的底部采用倾斜状设置,且活动块和横板之间构成升降安装结构。

[0011] 优选的,所述第二弹簧等间距分布在夹板的边侧,且夹板的边侧与芯片本体的外壁之间为紧密贴合。

[0012] 优选的,所述芯片本体关于安装板的轴线对称设置,且芯片本体的外侧对称设置有夹板。

[0013] 与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:该具有防磨损结构的载波芯片,载波芯片在使用时安装较为稳定,并且不易出现磨损损坏的情况,提高了整体的实用性;

[0014] 1. 芯片本体在使用的过程,通过横板外侧的防护垫对其外壁进行覆盖包括,以此提高了芯片本体在使用时耐磨性能,当芯片本体需要拆卸时,手动转动连接轴,连接轴转动后能够带动齿轮转动,接着齿板能够带动压板移动,接着活动块被带动向上移动,从而能够对横板以及竖板进行拆卸;

[0015] 2. 竖板的外侧设置了能够滑动的夹板,当芯片本体在使用时,通过等间距分布的第二弹簧能够带动夹板向外移动,并且使得夹板与芯片本体的外壁贴合,以此能够起到对芯片本体夹紧固定的作用。

附图说明

[0016] 图1为本实用新型整体俯视结构示意图;

[0017] 图2为本实用新型整体正视剖面结构示意图;

[0018] 图3为本实用新型图2中A处放大结构示意图;

[0019] 图4为本实用新型齿轮与齿板连接结构示意图。

[0020] 图中:1、安装板;2、横板;3、连接轴;4、齿轮;5、齿板;6、压块;7、活动块;8、第一弹簧;9、竖板;10、限位槽;11、防护垫;12、第二弹簧;13、夹板;14、连接板;15、芯片本体;16、固定块。

具体实施方式

[0021] 下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。

[0022] 请参阅图1-4,本实用新型提供一种技术方案:一种具有防磨损结构的载波芯片,包括安装板1、横板2、连接轴3、齿轮4、齿板5、压块6、活动块7、第一弹簧8、竖板9、限位槽10、防护垫11、第二弹簧12、夹板13、连接板14、芯片本体15和固定块16,安装板1的外侧安装有横板2,且横板2的中间位置设置有连接轴3,并且连接轴3的中间位置固定有齿轮4,齿轮4的外侧连接有齿板5,且齿板5与齿轮4之间为活动连接,并且齿板5的端头处固定有压块6,压块6的外侧设置有活动块7,且活动块7的内部设置有第一弹簧8,竖板9安装于横板2的端头处,且竖板9的上表面开设有限位槽10,并且横板2的边侧固定有防护垫11,竖板9的表面连接有第二弹簧12的一端,且第二弹簧12的另一端设置有夹板13,连接板14固定于安装板1的中间位置,且连接板14的外侧设置有芯片本体15,并且芯片本体15的端头处固定有固定块16;

[0023] 齿板5关于齿轮4的轴线对称设置有2个,且齿板5与齿轮4之间为啮合连接,当连接轴3被转动时,连接轴3能够带动齿轮4转动,接着齿轮4能够带动对称设置的齿板5向外滑动;

[0024] 压块6与齿板5之间为一体化设置,且压块6和横板2之间构成滑动安装结构,当齿板5被带动移动时,齿板5能够带动压块6向外移动;

[0025] 活动块7的底部采用倾斜状设置,且活动块7和横板2之间构成升降安装结构,当压块6被带动向外进行移动时,压块6能够将活动块7向外进行挤压,接着活动块7能够从限位

槽10的内部脱离,以此能够完成对横板2以及竖板9的拆卸;

[0026] 第二弹簧12等间距分布在夹板13的边侧,且夹板13的边侧与芯片本体15的外壁之间为紧密贴合,通过等间距分布的第二弹簧12能够起到带动夹板13移动的作用,接着能够夹板13对芯片本体15进行固定;

[0027] 芯片本体15关于安装板1的轴线对称设置,且芯片本体15的外侧对称设置有夹板13,提高了芯片本体15安装的稳定性,不会出现掉落或安装不稳的情况。

[0028] 工作原理:在使用该具有防磨损结构的载波芯片时,根据图1-4所示,芯片本体15在使用时,安装板1在使用时,其外部受到防护垫11对其进行覆盖保护,以此能够避免安装板1在使用时出现磨损损坏的情况,当横板2与竖板9需要拆卸时,手动转动连接轴3,连接轴3转动后能够带动齿轮4转动,接着对称设置的齿板5向外移动,然后压块6跟随其移动,并且带动活动块7向上移动从限位槽10的内部脱离,以此能够完成对横板2的拆卸,从而间接能够对竖板9进行拆卸,降低安装板1检修的难度,当竖板9与横板2需要安装时,反向转动连接轴3,此时活动块7不受压力,第一弹簧8能够带动其复位,完成卡合固定;

[0029] 根据图1所示,装置在使用的过程中,芯片本体15的外侧对称设置了夹板13,通过夹板13能够起到对芯片本体15固定的作用,以此能够避免芯片本体15在使用时出现安装不稳的情况。

[0030] 最后应当说明的是,以上内容仅用以说明本实用新型的技术方案,而非对本实用新型保护范围的限制,本领域的普通技术人员对本实用新型的技术方案进行的简单修改或者等同替换,均不脱离本实用新型技术方案的实质和范围。

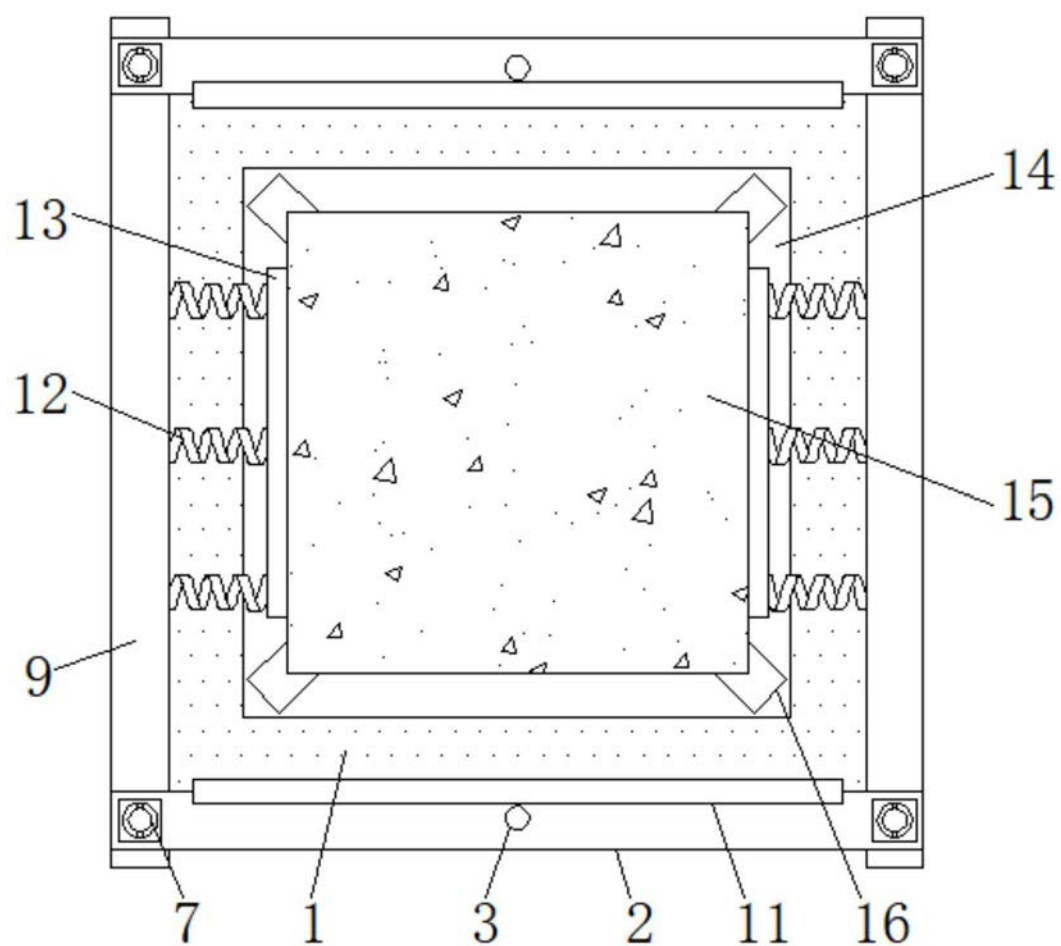


图1

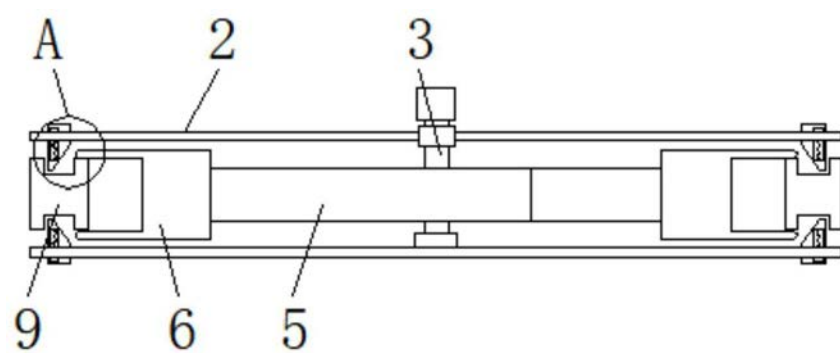


图2

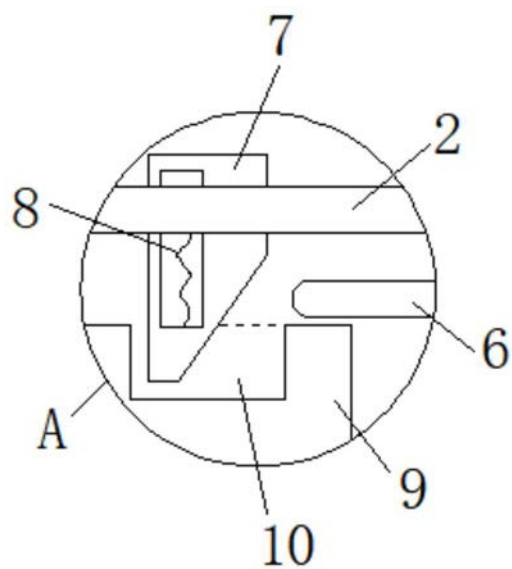


图3

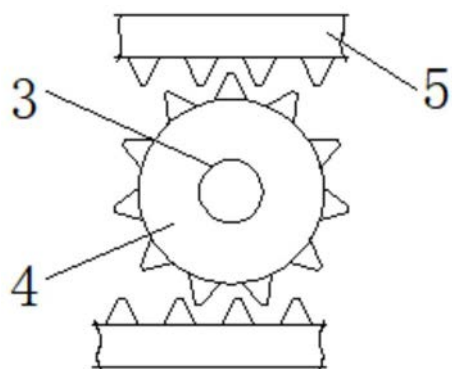


图4